

イベント出展の様子

第3回 おおた研究・開発フェア

10/3(木)~10/4(金) 大田区産業プラザPiO

モノづくりのまちを自負する東京都大田区では大学と産業界のシーズとニーズの交流の場として「おおた研究・開発フェア」を主催しており、大田区産業プラザで10月3日(木)から4日(金)まで行われ、2日間で1,731人(初日767人、2日目964人)の来場者がありました。

HI-Cubeからは、(株)分光応用技術研究所さんと(株)希望光学システムさんが出展されました。



大学等の研究機関の出展が多く、他の展示会に比べて来場者数は多くないもののマスコミの取材が多く、出展料が1万円と格安なため出展の練習を行うには最適な展示会である。レンズの傷検査装置や画像寸法計測装置には、問い合わせは多いものの商談につながる話を得ることは出来なかったが、パンフレットの不備や商品の完成度など、展示会を通して改めて気がつく点も多く東京近辺のお客様を展示会に招待して商談をすることも出来るので、このような格安の展示会には出展した方が良かったと感じた。

★出展者の声★

〔(株)分光応用技術研究所 松本社長 談〕

今年度で2回目の出展。研究開発型の企業ならびに大学のブースが多く、頂いた名刺とヒアリングから具体的な装置より新規のアイデアを探している来場者が多い様に思われた。出展費用が1ブース1万円と格安である。

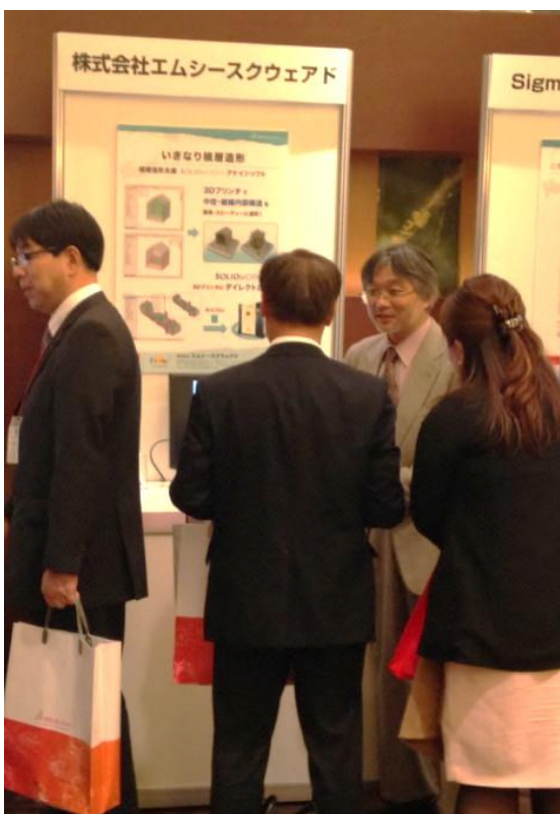
弊社展示品は、分光イメージングユニット(可視タイプ)と干渉フィルタ使用の分光イメージング装置(可視タイプ)である。引合いとして、1:セラミック材のスペクトルについての問い合わせ、2:近赤外700-1,700nmを用いた工業製品試料の内部品質測定等の具体的な話もあった。

また、弊社の両隣ブースとも、ファイバグレーティングを用いた製品紹介をしていたため、弊社研究開発の参考になった。本展示会で得た情報を元に、開発方向性の調整を行い、且つ、売上げに繋げていきたい。



SOLID WORKS WORLD JAPAN 2013

11/12(火) ホテル日航東京



本展は、(米)ダッソー・システムズ・ソリッドワークス社の日本法人ソリッドワークスジャパン(株)が主催する設計ソリューションなどソフトウェアの技法習得に関連する情報の展示を目的としています。

毎年、東京と大阪で日を変えて行い、東京では11月12日(火) ホテル日航東京で開催され、約1,200人の来場者がありました。

HI-Cubeからは、(株)エムシースクウェアドさんが出展されました。

★出展者の声★

〔(株)エムシースクウェアド 大野社長 談〕

弊社開発のパッケージソフト「いきなり積層造形」を出展した。この製品は、ソリッドワークス上のアドインとして提供する。ソリッドワークス上のソリッドモデルから、直接3Dプリンタを駆動する造形パスを出力するソフトウェアである。会場には流行の3Dプリンタも搬入され来場者の関心を集めていた。ただしこれらの造形素材は樹脂ばかりであり、金属の造形が(しかも国産の装置で!)可能であることはほとんど知られていなかった。装置が普及すれば、次はモデル作成ソフトに関心に移るはず。弊社の出番である。